JCU CORPORATION

第64期・2024年3月期 決算説明資料

株式会社JCU

東証プライム　4975

2024年5月10日(金)

2024年3月期　業績概況

【累計会計期間】 JCU（単体）⇒ 2023.4～2024.3
海外子会社　⇒ 2023.1～2023.12

薬品事業	電子分野向け	■中国は一部のプリント基板メーカーにおいて回復基調がみられたものの、スマートフォンをはじめとする高機能電子デバイス向けプリント基板の需要が低迷し、薬品売上高は前年同期比で横ばいに推移 ■台湾はサーバー、高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が低迷し、薬品売上高は前年同期比で減少 ■韓国は半導体市場の不調が継続したため半導体パッケージ基板の需要が低迷し、薬品売上高は前年同期比で減少
	自動車分野向け	■日本は半導体・部材不足が緩和されたことにより自動車の生産台数は増加したものの、自動車の部品構成の変更に伴う薬品需要の低下及び当第４四半期においては自動車産業の出荷停止の影響を受け、薬品売上高は前年同期比で減少 ■中国は半導体・部材不足の緩和に伴い自動車の生産台数は増加したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が低下し、薬品売上高は前年同期比で減少
装置事業		■経済活動の正常化に伴う新規投資需要の増加により、売上高及び受注残高は増加

2024年3月期　連結実績

(単位：百万円)

決算期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期		
	実績	実績	予想	実績	対前期増減率
売上高	24,256	27,137	25,000	24,859	△8.4%
営業利益	8,990	9,285	7,000	8,041	△13.4%
経常利益	9,231	9,369	7,000	8,216	△12.3%
親会社株主に帰属する当期純利益	6,370	6,013	4,800	5,530	△8.0%
1株当たり当期純利益	243円82銭	232円62銭	187円30銭	216円95銭	―

貸借対照表　要約

（百万円）	2023年3月期	2024年3月期
流動資産	36,646	40,831
現金及び預金	24,180	27,037
受取手形及び売掛金	8,526	10,171
たな卸資産	2,852	2,518
固定資産	8,255	8,810
有形固定資産	6,081	6,165
投資その他の資産	2,126	2,602
資産合計	44,901	49,641
流動負債	6,164	6,664
支払手形及び買掛金（電子記録債務含む）	2,397	3,122
短期借入金（一年内長期含む）	754	616
固定負債	875	727
長期借入金	288	121
負債合計	7,039	7,391
純資産合計	37,861	42,250
負債・純資産合計	44,901	49,641

※一部の勘定科目について省略しております。

為替レート

為替感応度（連結年換算）：下記主要通貨 1%の変動で、連結営業利益 1.05億円程度

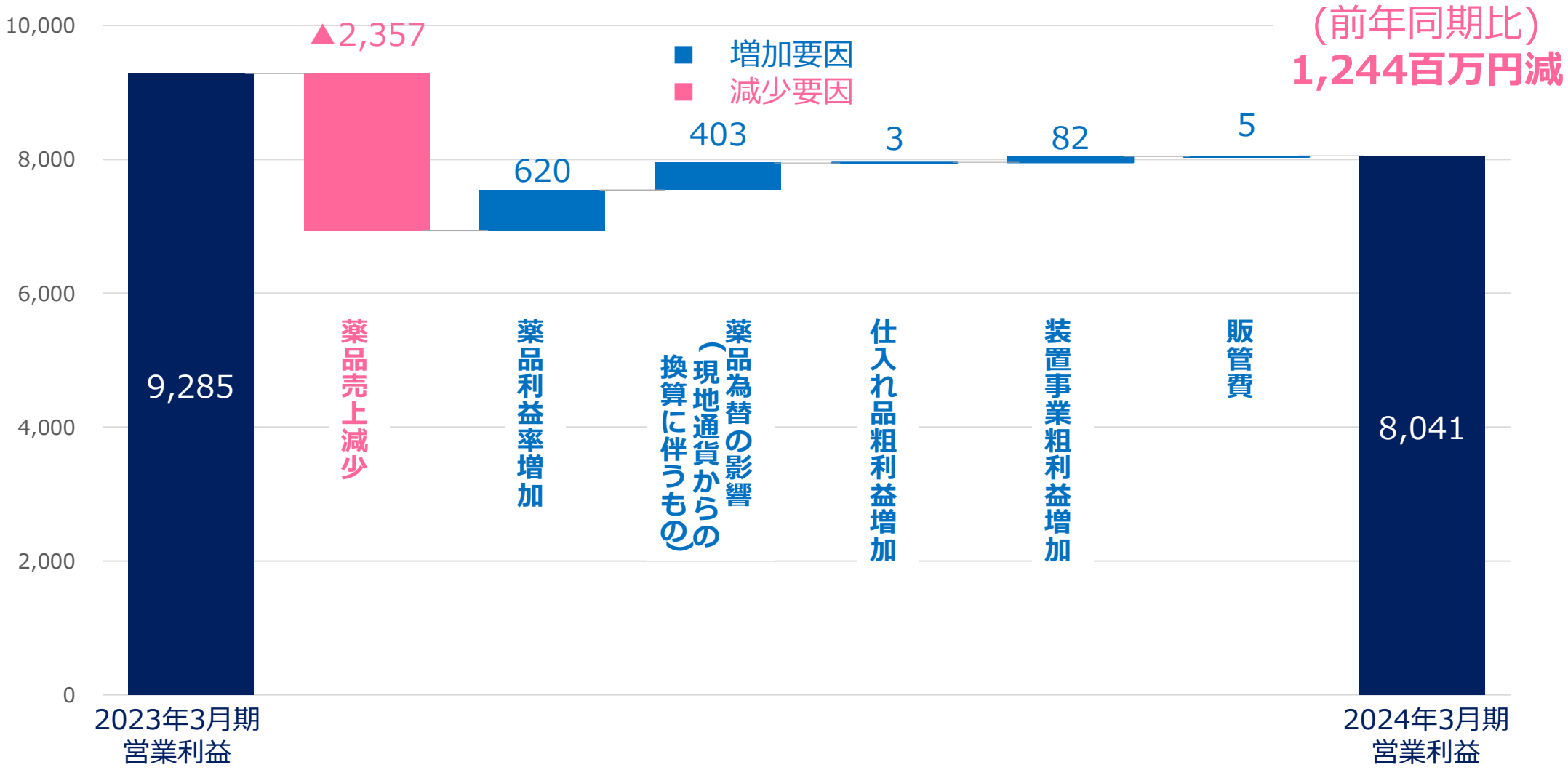
(単位：円)

	2023年3月期	2024年3月期				2025年3月期(予想)
		1Q (期首予想)	2Q	3Q	4Q	
中国人民元（CNY）	19.48	19.34	19.45	19.61	19.82	20.40
台湾ドル（TWD）	4.41	4.36	4.42	4.47	4.51	4.60
韓国ウォン（KRW）	0.1017	0.1039	0.1042	0.1062	0.1076	0.1100

(注) 当社の主要な外国通貨は、中国人民元・台湾ドル・韓国ウォンであり、
いずれも、期中平均レートを採用しております。

2024年3月期　連結営業利益　増減内容

(単位：百万円)



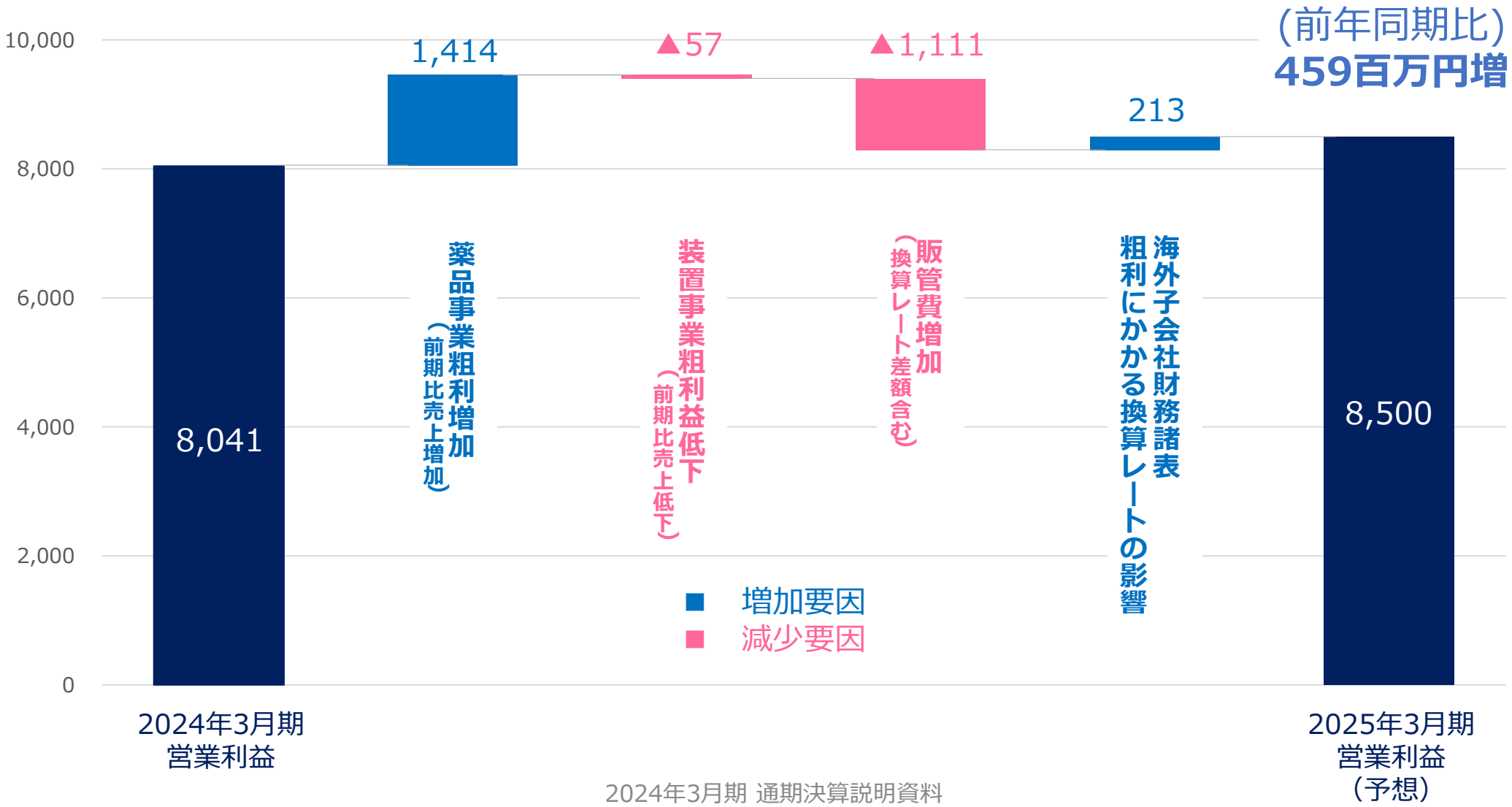
2025年3月期　業績予想

(単位：百万円)

決算期	2024年3月期 実績	2025年3月期 予想	前期に対する 増減率
売上高	24,859	27,000	8.6%
営業利益	8,041	8,500	5.7%
経常利益	8,216	8,500	3.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	5,530	5,900	6.7%
1株当たり当期純利益	216円95銭	232円90銭	―

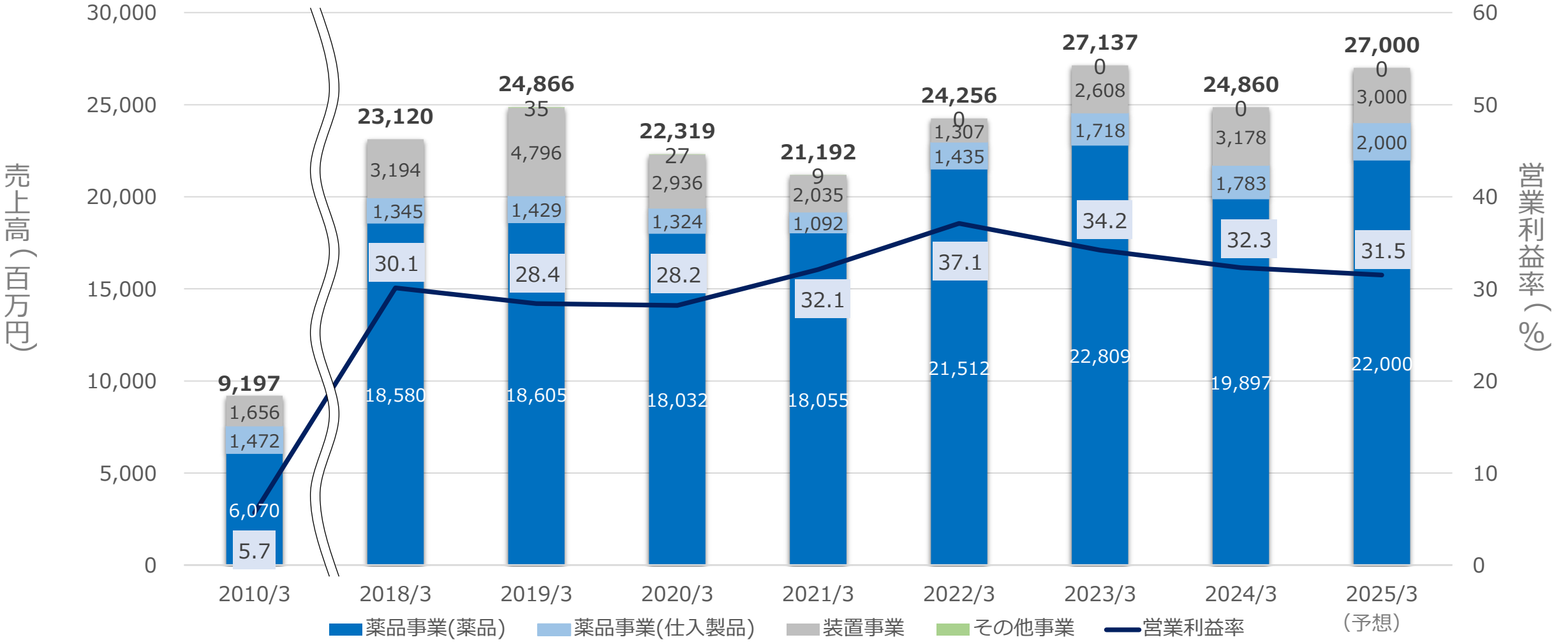
2025年3月期　連結営業利益　業績予想

(単位：百万円)



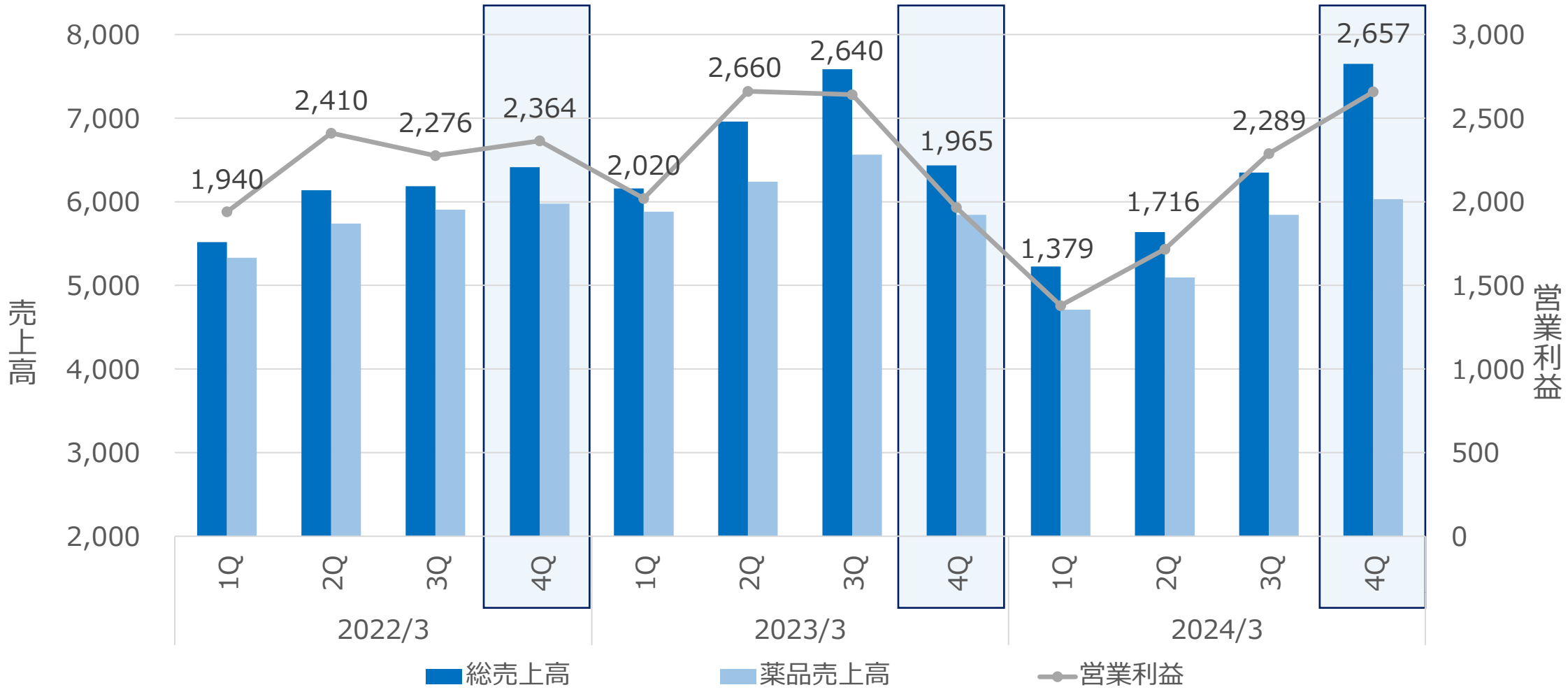
(前年同期比)
459百万円増

年度別　連結業績の推移（セグメント別）

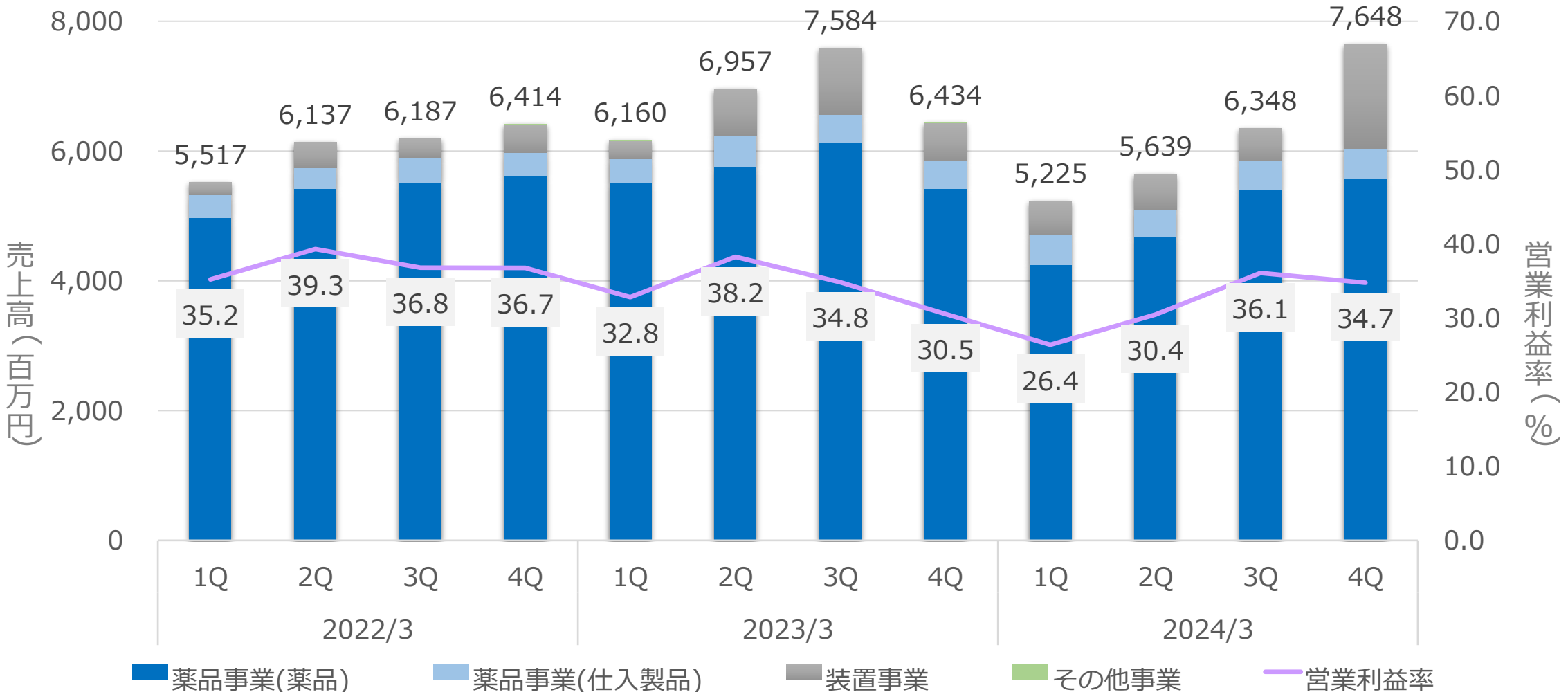


四半期別　連結業績の推移

(単位：百万円)

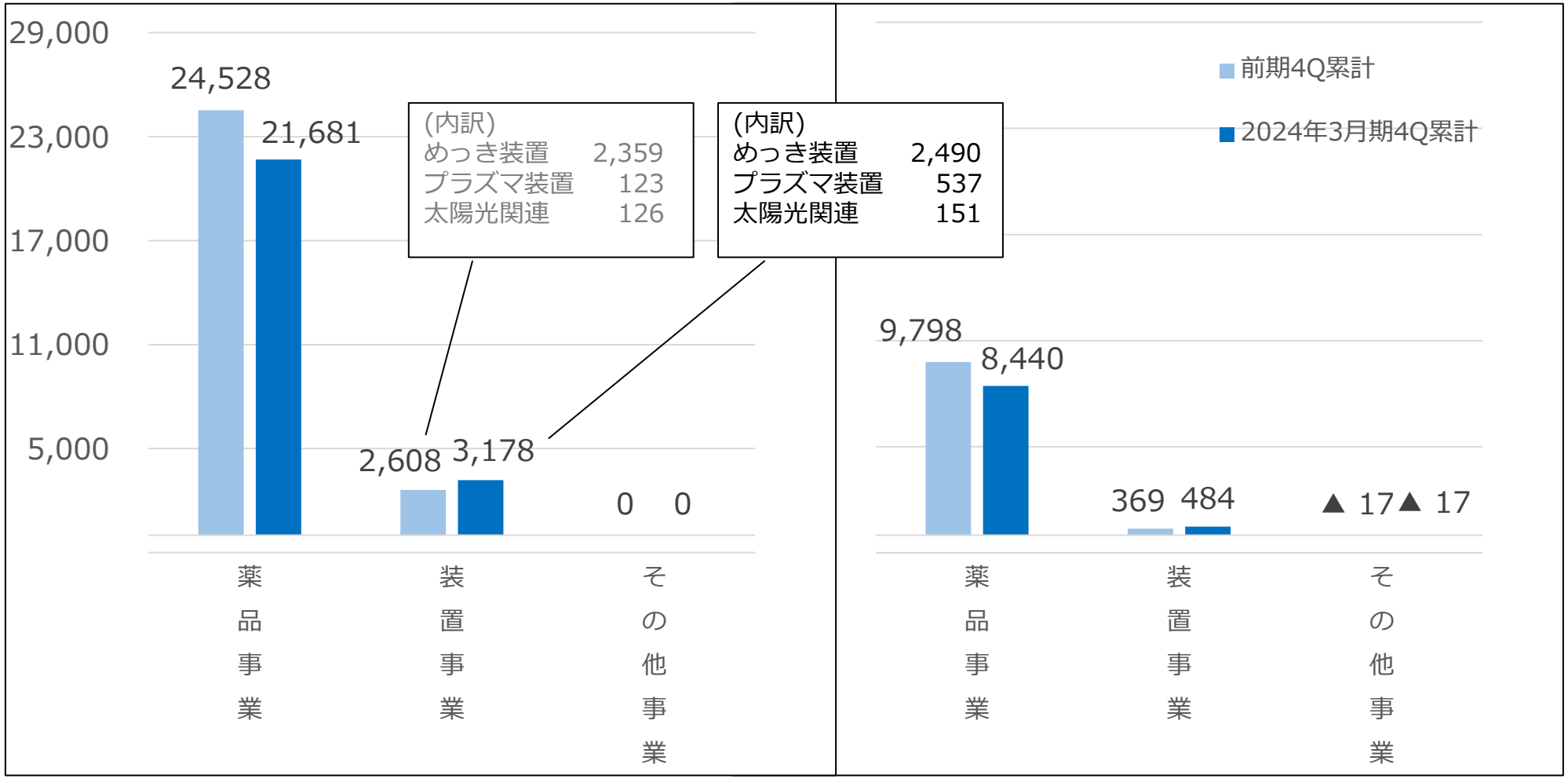


四半期別　連結業績の推移(セグメント別)



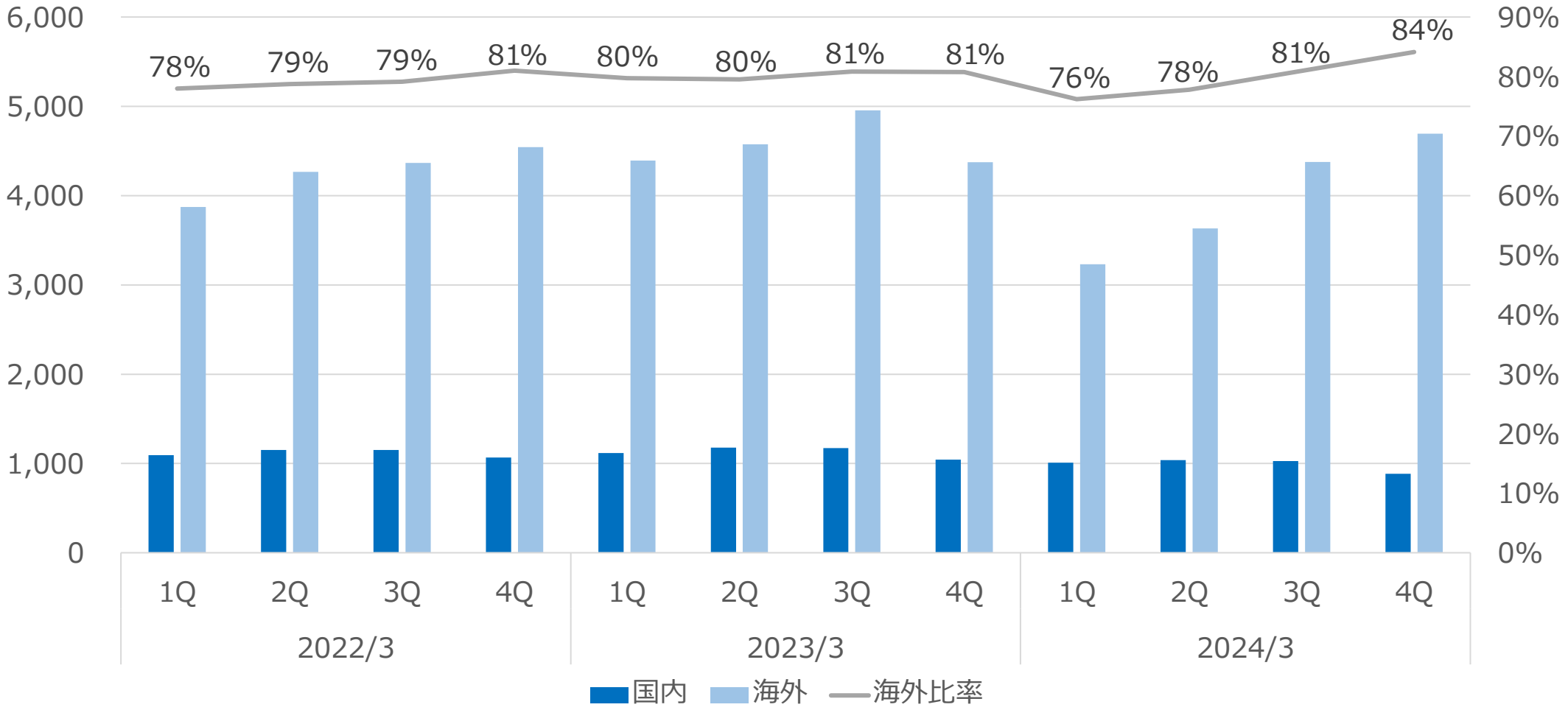
2024年3月期　連結セグメント業績

(単位：百万円)

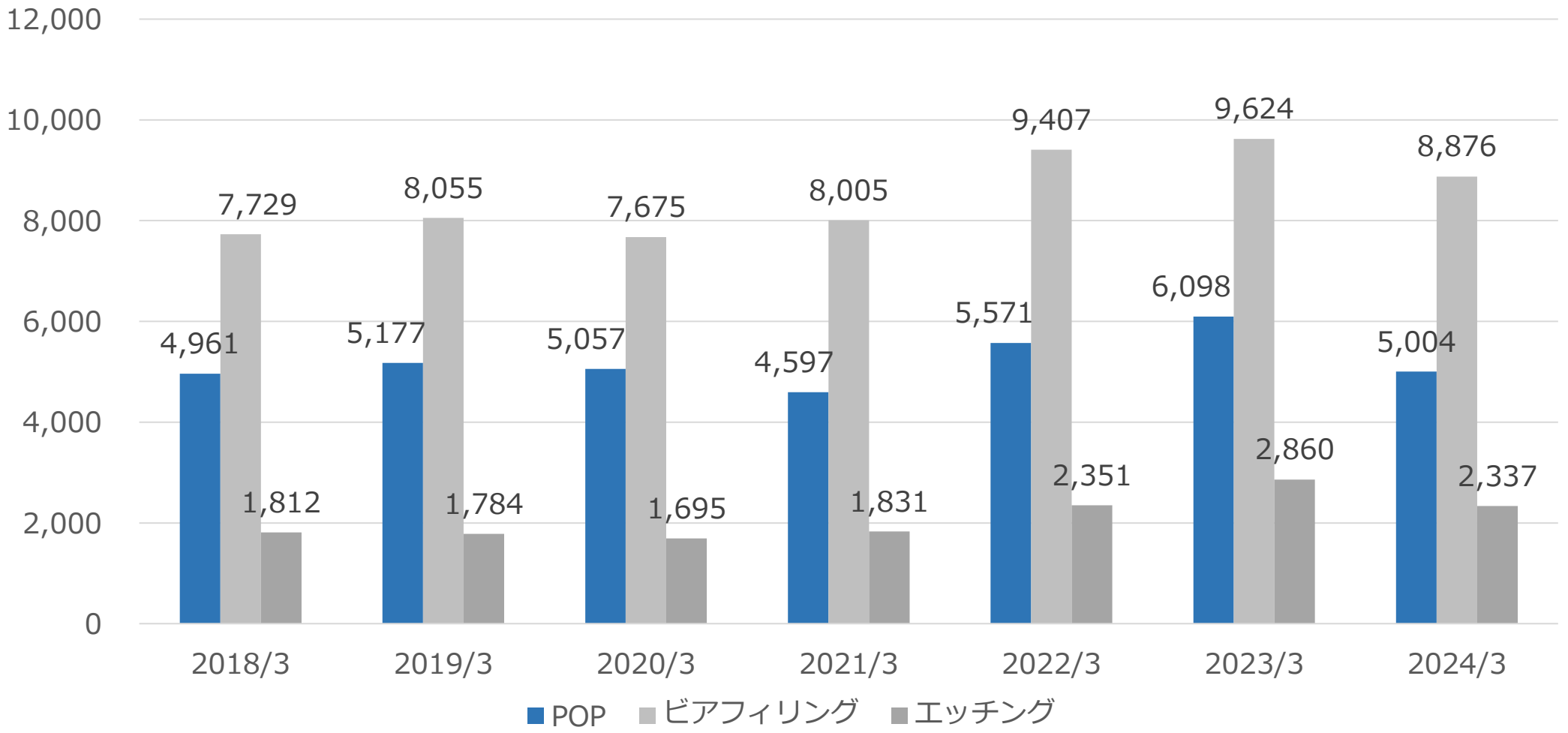


四半期別　国内外薬品売上高推移

(単位：百万円)



年度別　POP, ビアフィリング, エッチング薬品売上高推移

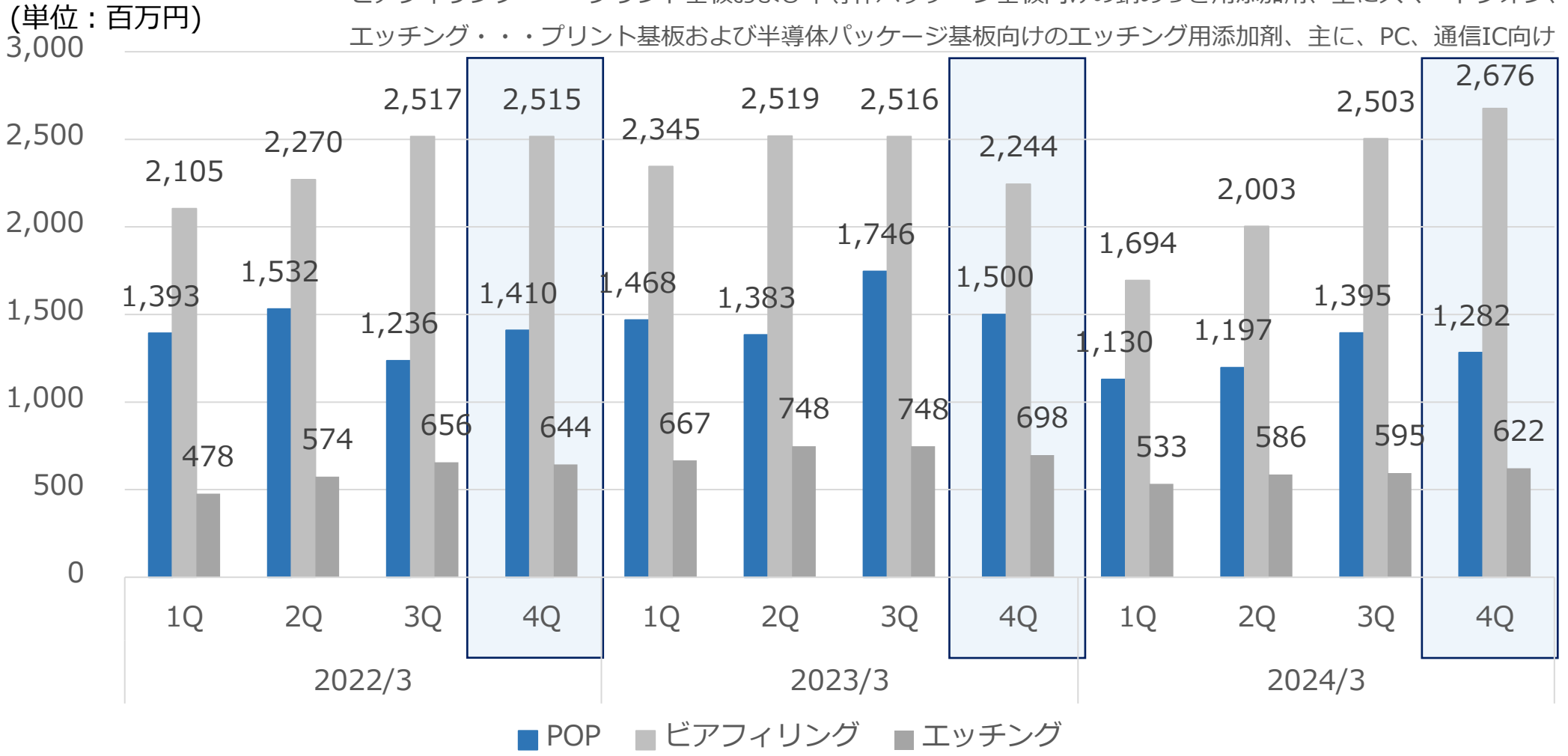


四半期別　POP, ビアフィリング, エッチング薬品売上高推移

POP (Plating on Plastics) ・・・ プラスチック上へのめっきで、主に自動車部品向け

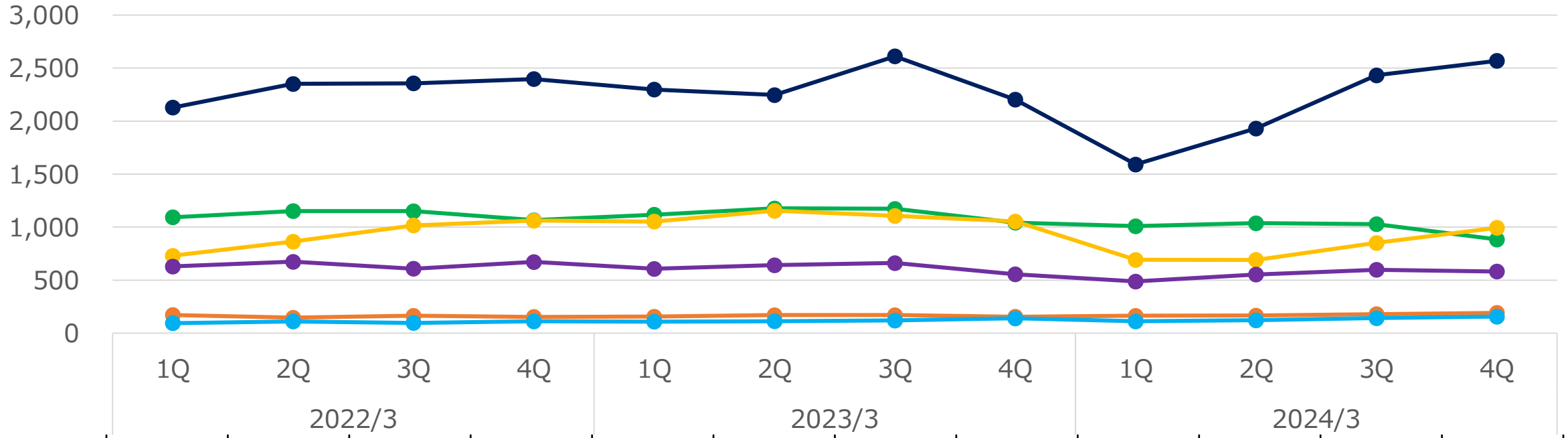
ビアフィリング・・・プリント基板および半導体パッケージ基板向けの銅めっき用添加剤、主にスマートフォン、PC向け

エッチング・・・プリント基板および半導体パッケージ基板向けのエッチング用添加剤、主に、PC、通信IC向け



四半期別　地域別薬品売上高の推移

(単位：百万円)

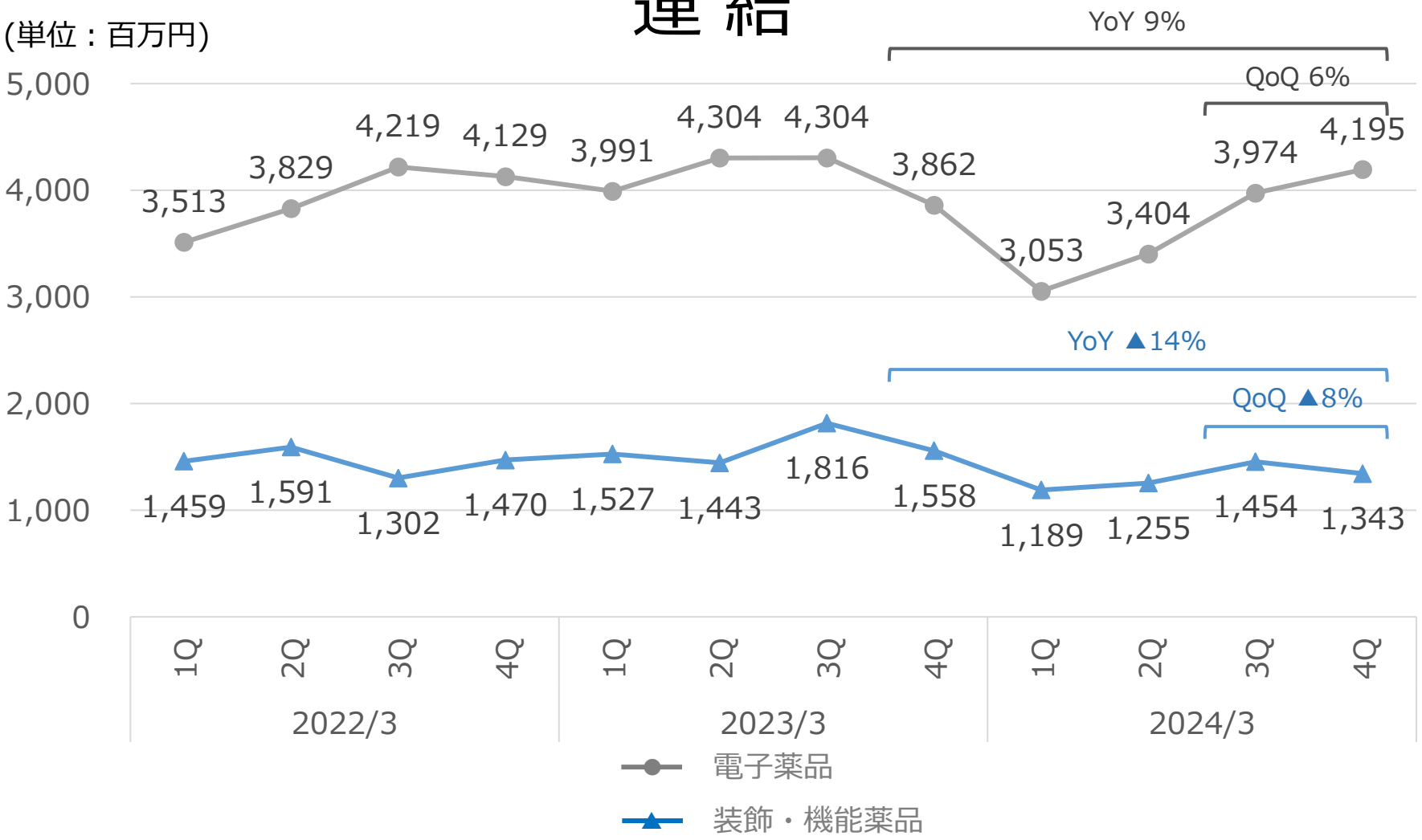


日本	1,092	1,152	1,150	1,166	1,117	1,177	1,173	1,043	1,009	1,038	1,028	884
中国	2,133	2,353	2,359	2,391	2,307	2,247	2,612	2,203	1,591	1,931	2,432	2,569
台湾	732	864	1,018	1,060	1,052	1,155	1,106	1,054	692	691	851	994
韓国	629	673	608	672	607	641	662	556	488	553	598	582
タイ	170	145	164	152	156	170	170	155	164	166	179	191
ベトナム	94	111	97	112	109	112	120	139	111	121	142	156

四半期別　地域別薬品売上高の推移

連 結

(単位：百万円)



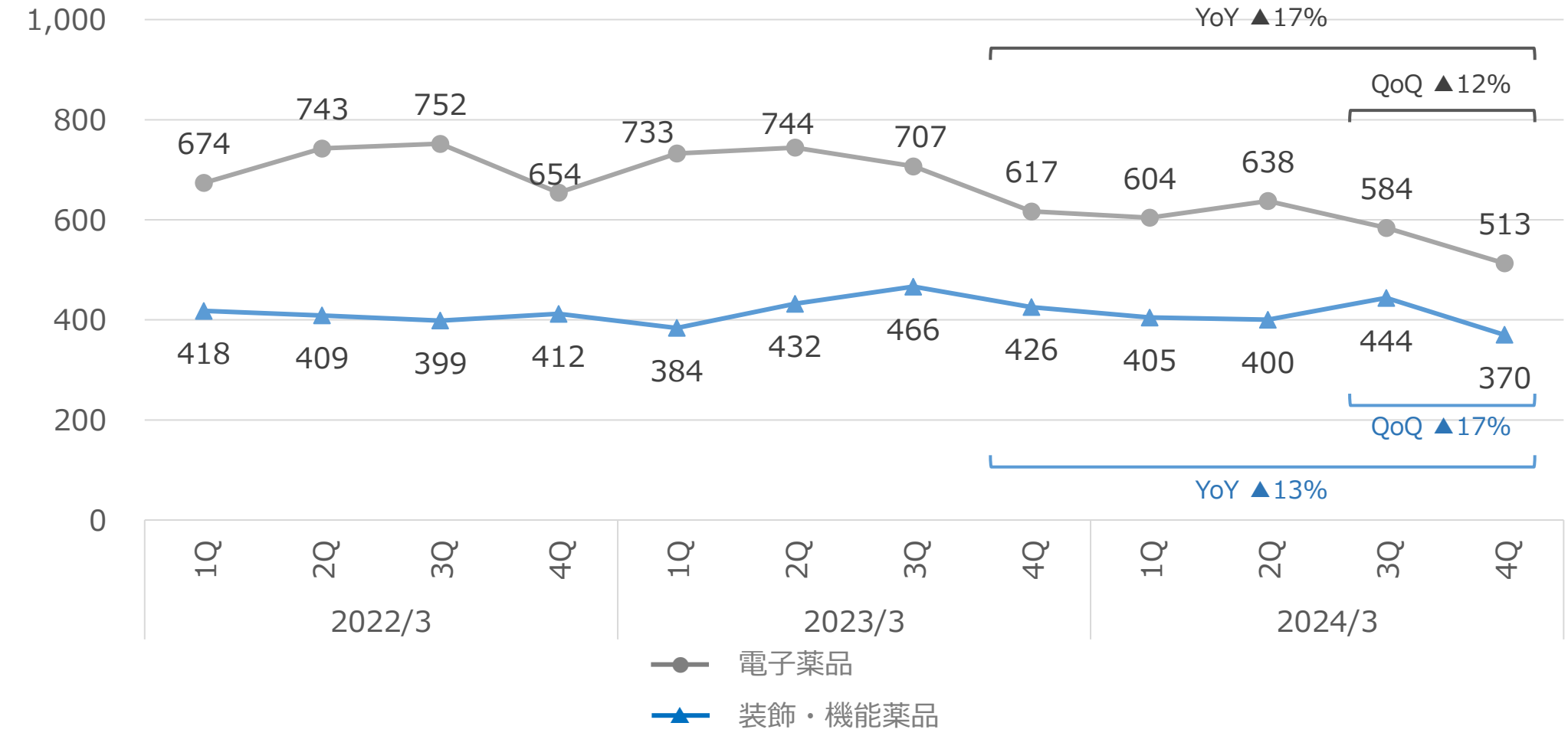
(電子薬品)　主力製品：ビアフィリング
プリント基板、コネクター、
半導体分野向けの表面処理(めっき)薬品

(装飾・機能薬品)　主力製品：POP
装飾、防錆分野向けの薬品
主に自動車部品、水栓金具等の
表面処理(めっき)薬品

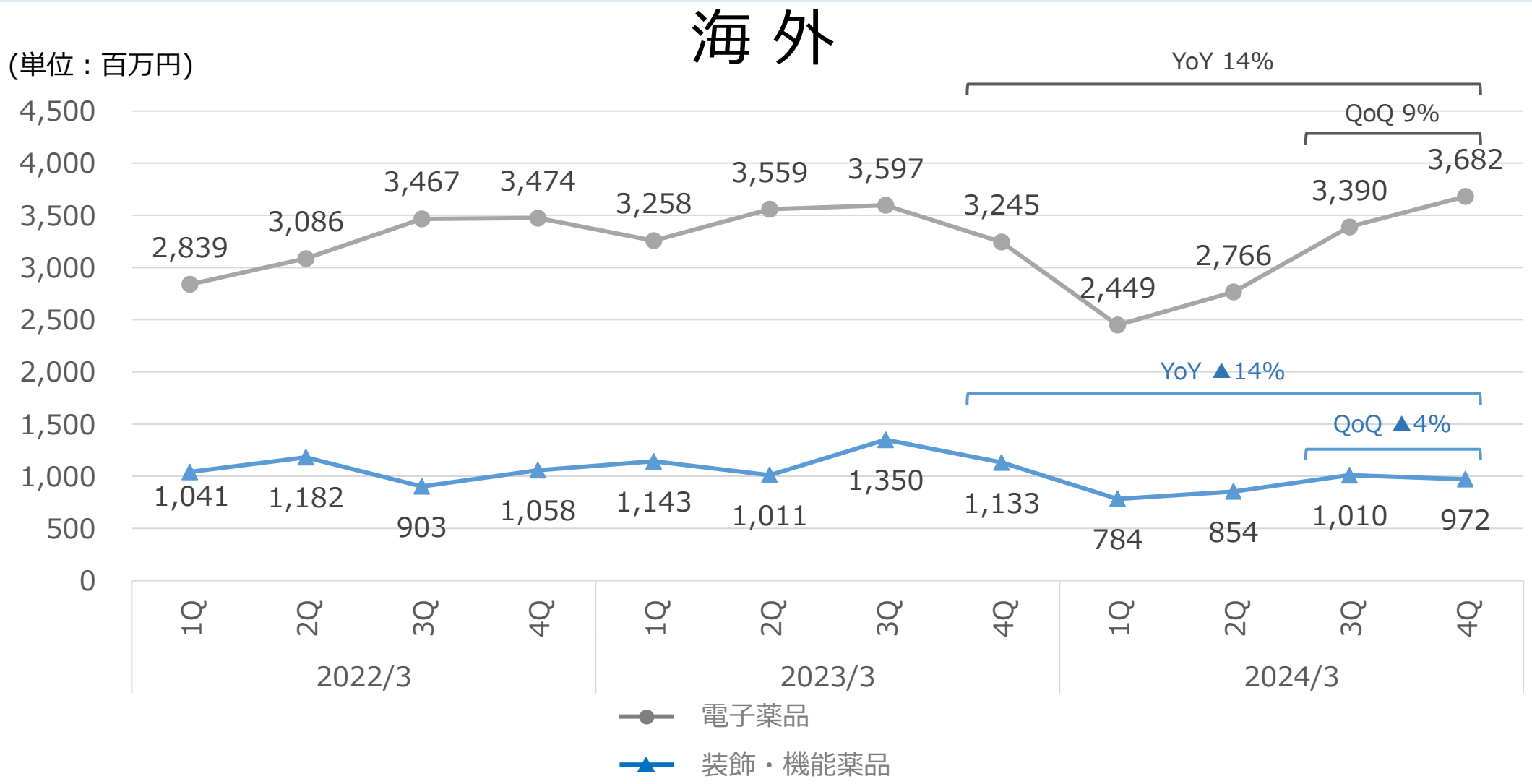
四半期別　地域別薬品売上高の推移

国 内

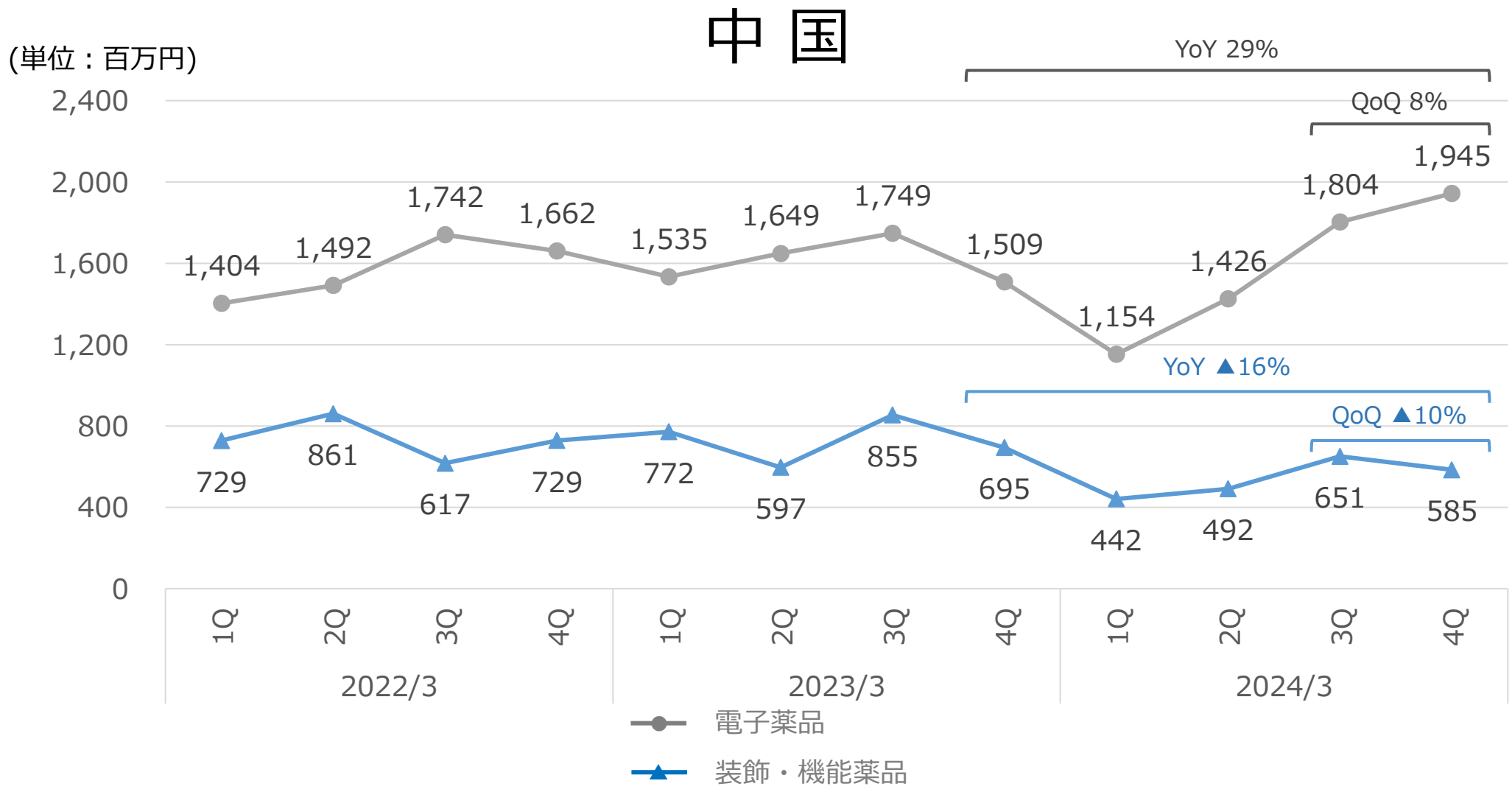
(単位：百万円)



四半期別　地域別薬品売上高の推移



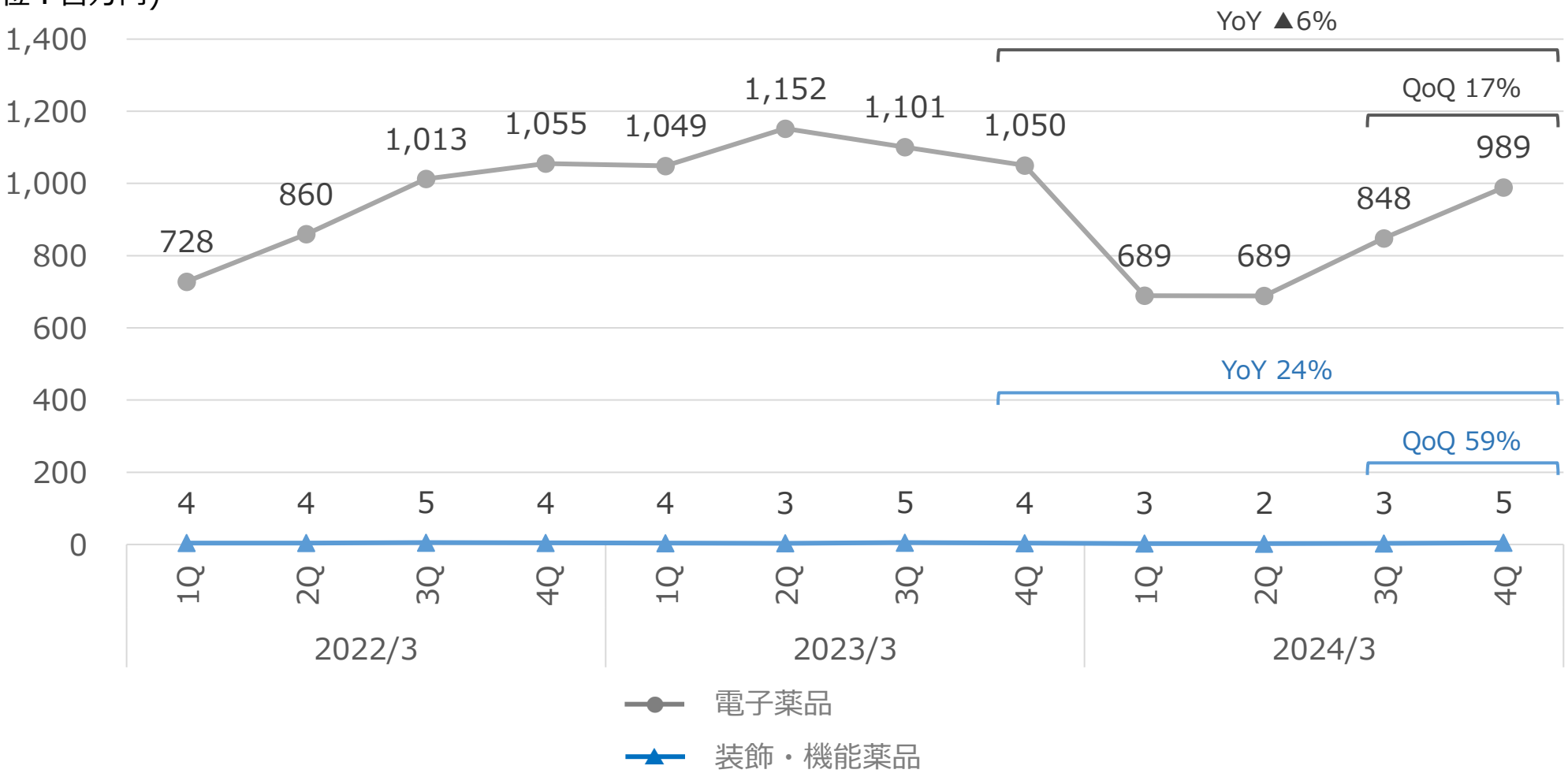
四半期別　地域別薬品売上高の推移



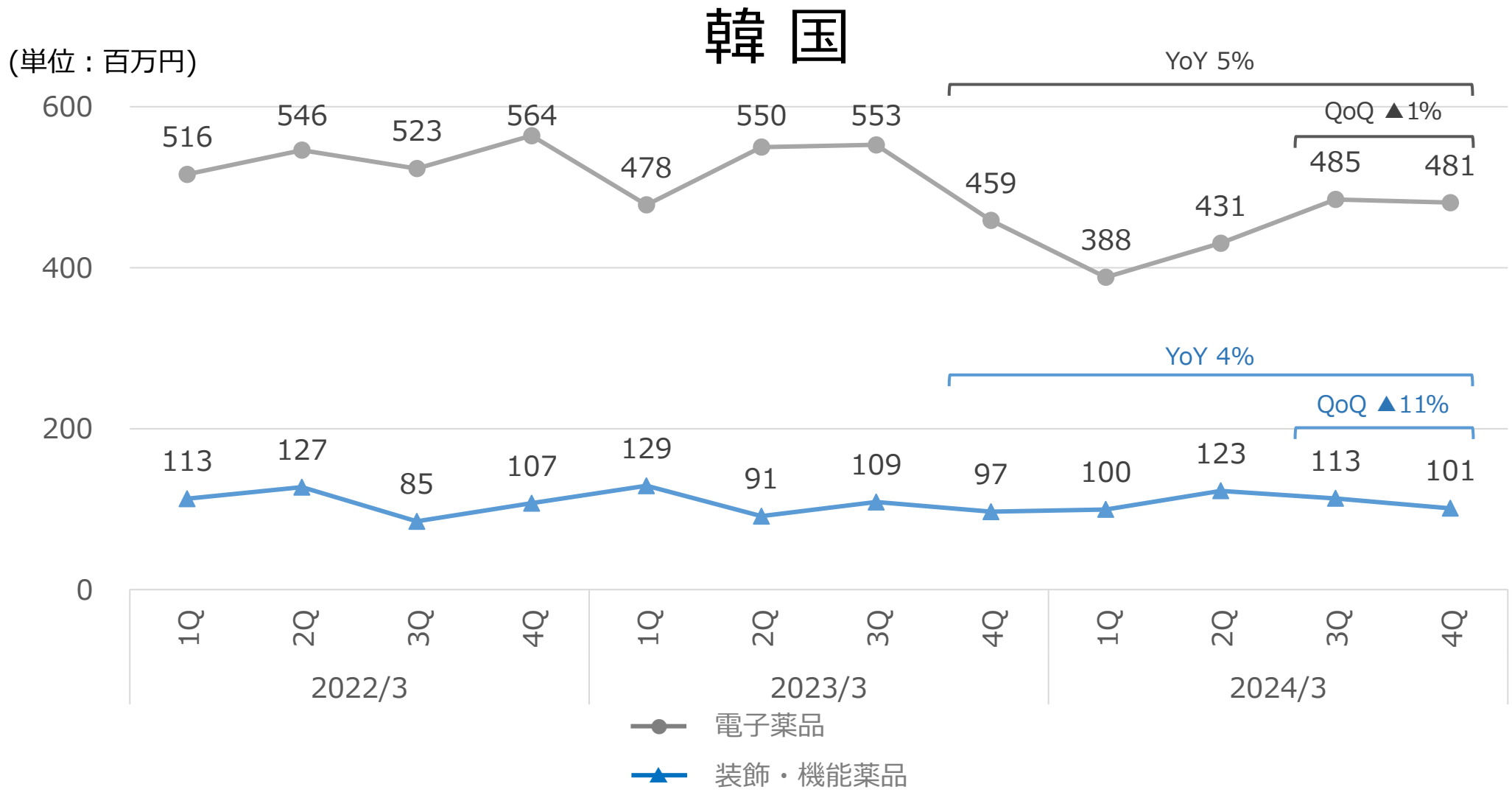
四半期別　地域別薬品売上高の推移

台湾

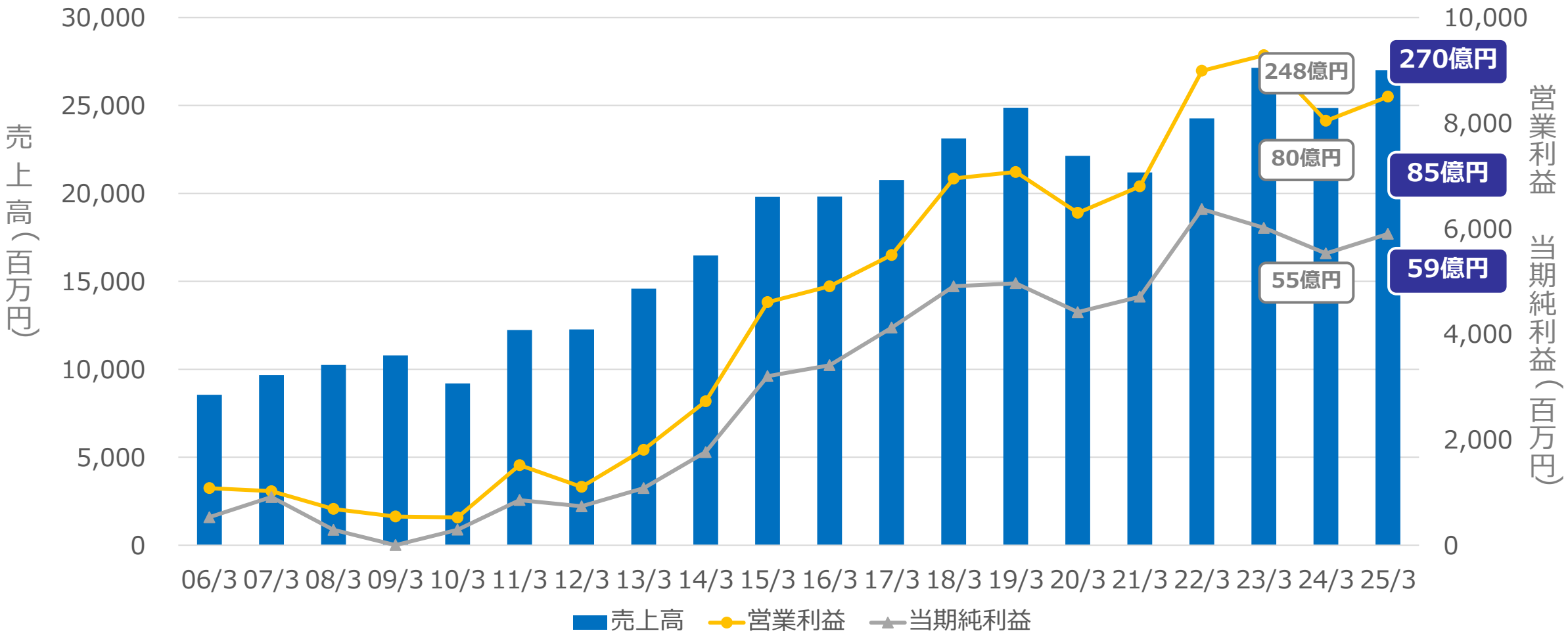
(単位：百万円)



四半期別　地域別薬品売上高の推移



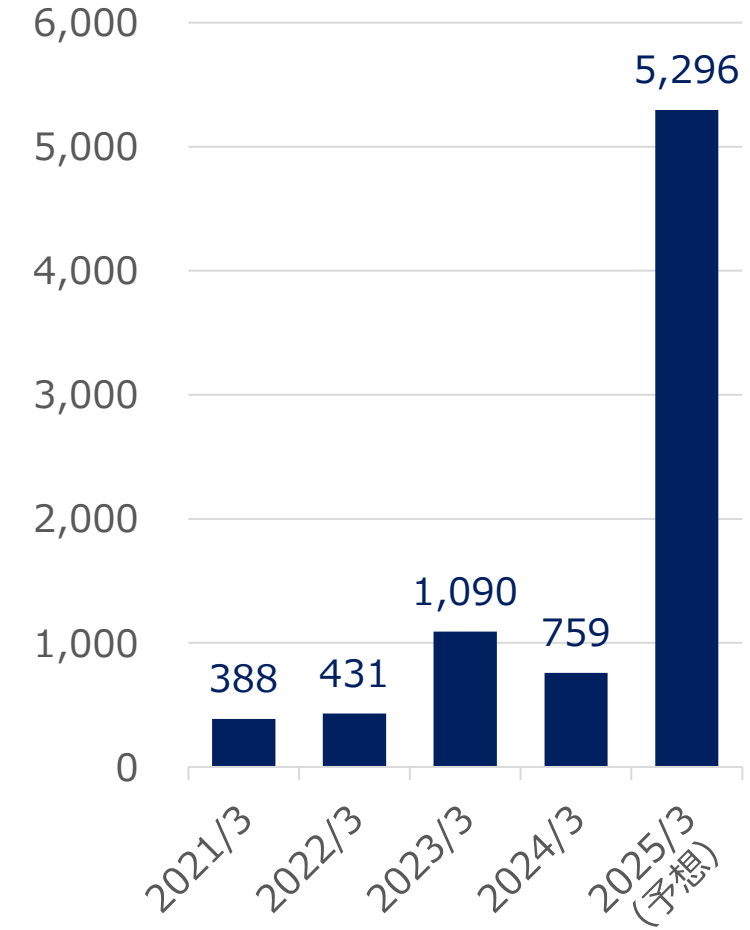
上場からの業績推移


30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
売上高（百万円）
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
営業利益　当期純利益（百万円）
06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3
248億円
270億円
80億円
85億円
55億円
59億円
売上高
営業利益
当期純利益

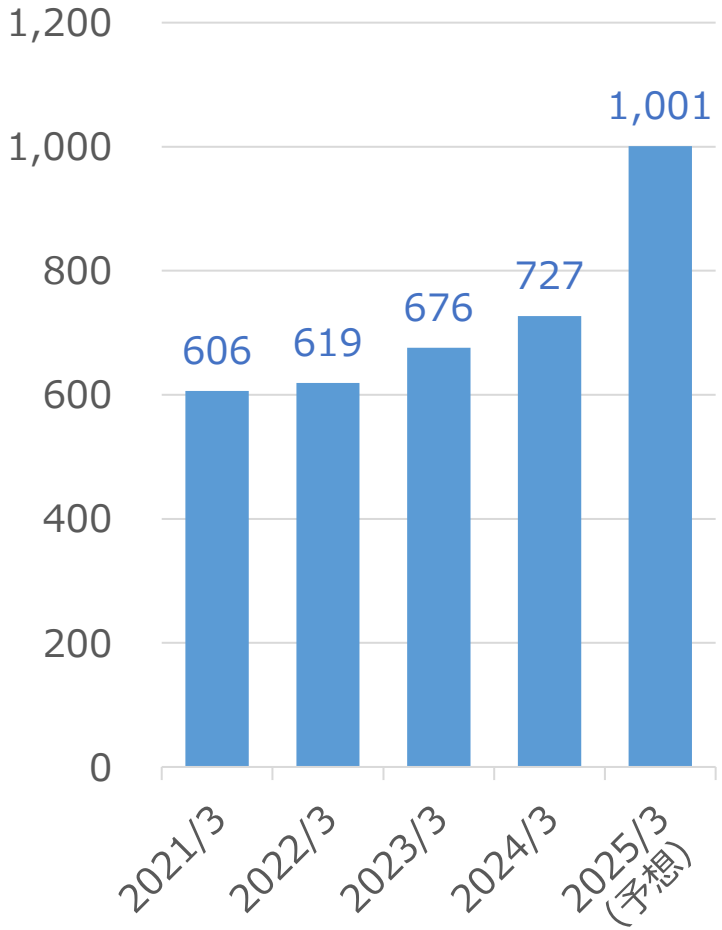
設備投資額、減価償却費および研究開発費

(単位：百万円)

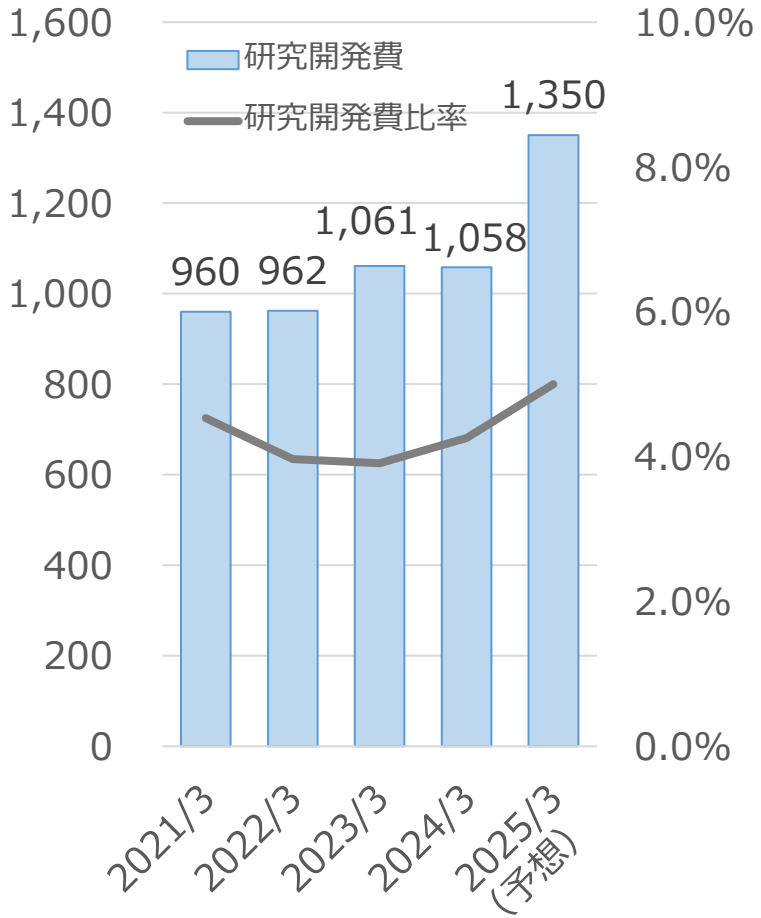
設備投資額



減価償却費



研究開発費および
売上高研究開発費比率

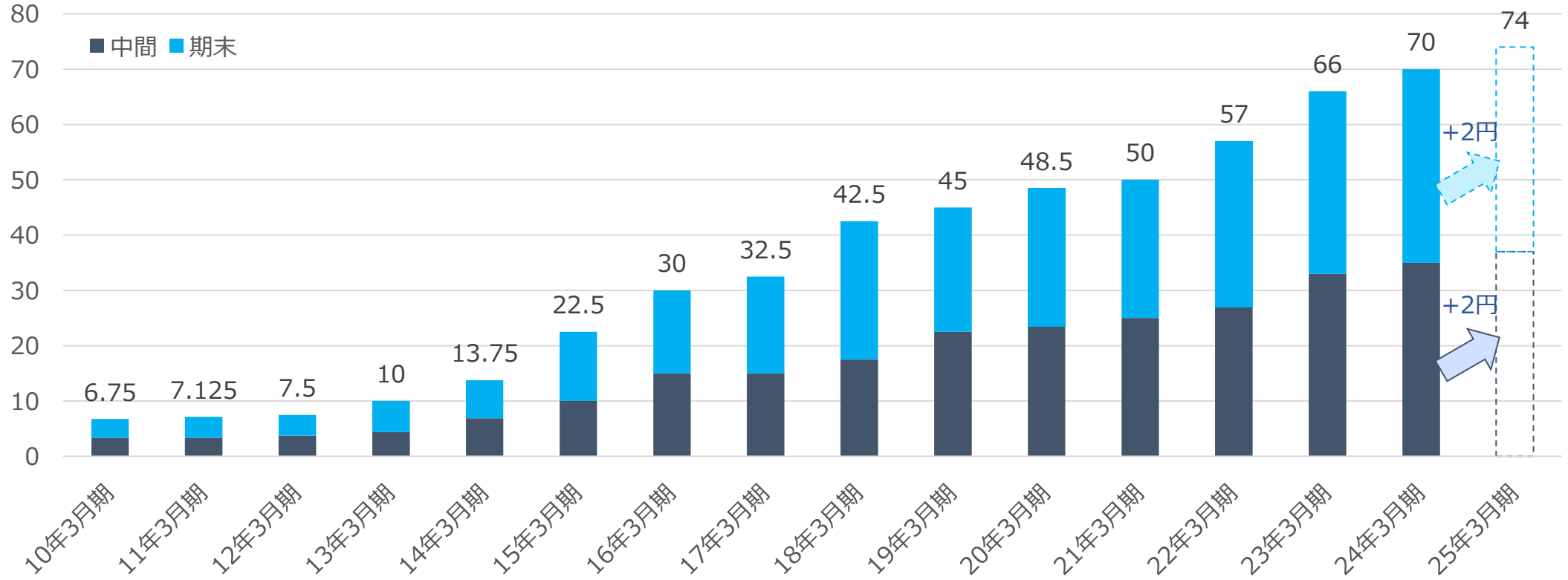


2025年3月期　配当予想

1株当たりの配当金（予想）

中間配当金：37円
期末配当金：37円

15期連続増配予定



当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいります。

配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。

ESGに関する取り組み

当社グループは、ESGに配慮した課題に事業活動を通じて取り組み、
持続可能な成長を続けるグローバル企業を目指してまいります。

Environment

環境配慮型製品の開発
- スタンプ式めっき処理装置および薬品
- 低環境負荷化学ニッケルめっきプロセス
- 低環境負荷装飾用硫酸銅めっきプロセス

CO_2排出量（単体）
1,057 t-CO_2【2023年3月期末】
※2013年度比27%削減

Social

女性管理職比率（単体）
11.6%　【2024年3月期末】

国内外拠点のISO9001取得状況
7か国12拠点　【2023年3月期末】
※日本、中国、台湾、韓国、タイ
ベトナム、メキシコ

Governance

企業統治の体制
- 取締役
  社内：6名、社外：4名（内、女性1名）
- 監査役
  常勤：1名、社外：3名（内、女性1名）

当社CSRレポート：https://www.jcu-i.com/sustainability/download/

参 考 資 料

- 新中期経営計画（概要）
- 会社概要
- 今後必要とされる表面処理技術
- 主な商流
- 主な製品
- 薬品用途説明 最終製品例

Next 50 Innovation 2nd の振り返り｜成果と課題

基本方針 Basic policy

コア事業の強化

ESG視点での経営基盤構築

成果 Outcome

- 新ブランド「TIPHARES シリーズ」の立ち上げ
- 主力製品の競争力強化
- 熊本事業所立ち上げ計画開始
- マレーシア拠点の設立
- グローバル生産体制の確立

- サステナビリティ経営の実践
  - 環境対応型製品の開発
  - CO_2削減への取り組み
  - TCFD提言への賛同表明
  - 海外赴任体験制度の新設
  - グループガバナンスの強化

課題 Issue

- 製品のさらなる強化
- 既存市場における拡販力強化
- 新ブランドの市場定着とスタッフの育成

- 人材育成
  - 国内外スタッフの育成
  - グローバルで活躍できる人材の育成
  - 経営視点を持つ人材の育成

新中期経営計画にて継続 »

JCU VISION 2035｜新経営理念体系

企業理念
表面処理技術から未来を創造する
～Explorer in Surface Engineering～

JCUグループの目指す企業像
わたしたちは挑戦し続ける姿勢と誠実な顧客対応を
つねに心がけ、未来に誇れる企業をめざします

経営ビジョン

長期ビジョン
JCU VISION 2035

2035年に目指す姿
独自の強みを最大限に活かし、
環境や社会に貢献することで、社会と
ともに成長し続けるグローバル企業

目指す姿に必要な要素
- ▶ 世界をリードする唯一無二の技術
- ▶ お客様から信頼されるサービス体制
- ▶ 透明性のある企業風土

経営計画

基本方針

攻め
- ▶ 成長分野への積極的な投資
- ▶ 経営基盤の強化
- ▶ DX推進によるデータの利活用

守り
- ▶ 既存市場における収益性強化
- ▶ サステナビリティ経営の推進
- ▶ 人的資本、知財・無形資産の活用

機能別戦略

開発部門 / 生産部門 / 営業部門 / 管理部門

中期経営計画
JCU VISION 2035 －1st stage－

JCU VISION 2035 –1st stage– ｜数値目標

JCU VISION 2035

1st stage

	（単位：百万円）	FY2024（実績）	FY2025（計画）	FY2026（計画）	FY2027（計画）		FY2035（長期目標）
収益性	売上高	24,859	27,000	29,000	31,000		50,000
	営業利益	8,041	8,500	9,100	10,000		17,500
	経常利益	8,216	8,500	9,100	10,000		17,500
	親会社株主に帰属する当期純利益	5,530	5,900	6,300	6,900		12,000

JCU VISION 2035 –1st stage– ｜基本方針

攻め

成長分野への積極的な投資

- 重点領域向け表面処理薬品の開発加速
- 次世代領域の開発に向けたリソース配分と体制の構築
- コア技術を活かした新規事業への挑戦

経営基盤の強化

- 財務目標値の達成
- 健全な財務基盤の維持
- 安定的な増配

DX推進によるデータの利活用

- DS※の獲得・育成およびMI活用加速による競争力強化
- オフィス業務における生産性向上
- 営業・生産活動におけるデータ活用に向けた基盤構築

※DS‥データサイエンティスト（Data Scientist）

守り

既存市場における収益性強化

- 自社の強みを活かした顧客対応力の強化
- グローバル販売体制の再構築
- 低環境負荷製品の積極的な拡販

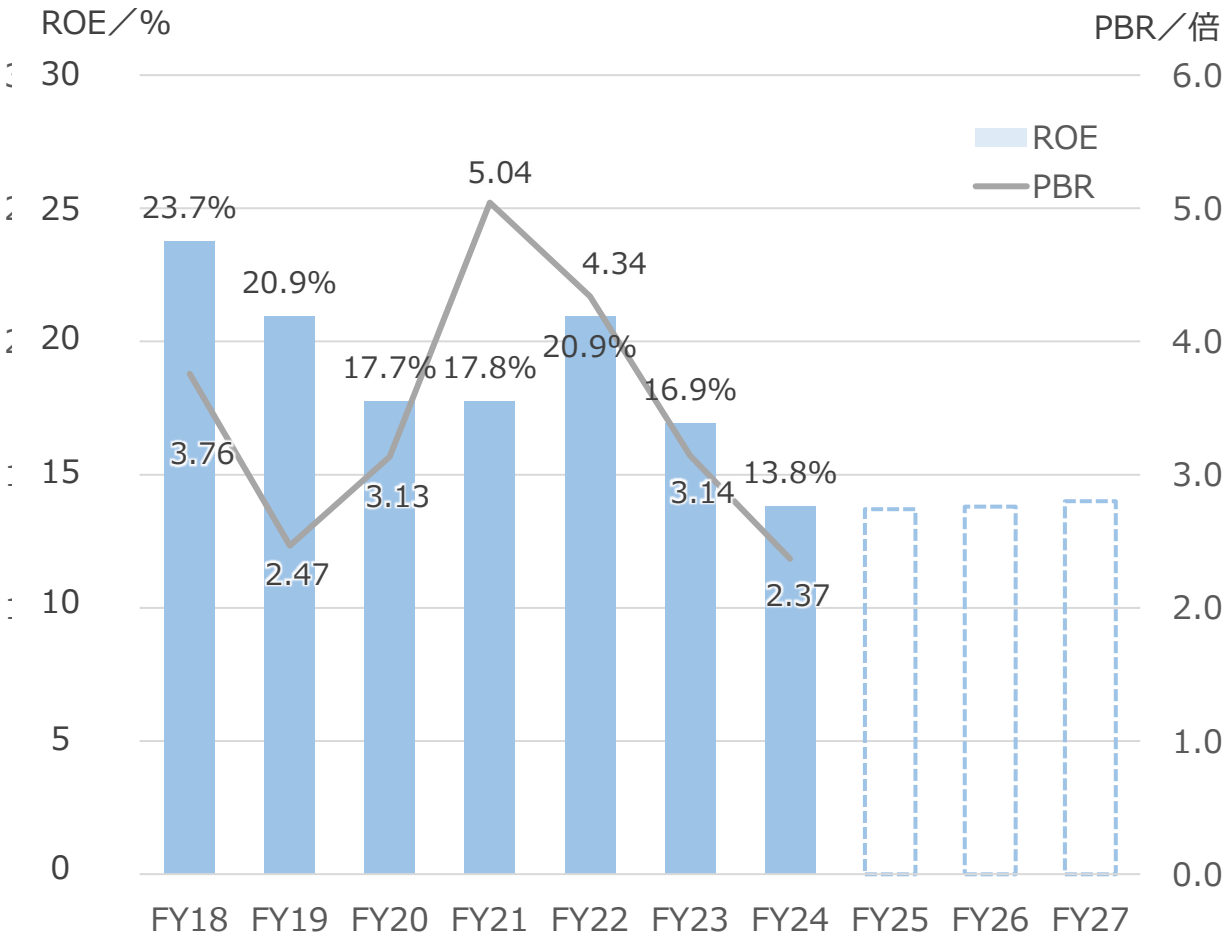
サステナビリティ経営の推進

- 重要課題の認知向上と施策実施
- 企業経営の透明性強化
- 非財務情報の開示充実

人的資本、知財・無形資産の活用

- 環境、戦略に合わせた人材獲得・育成
- 労働環境、働き方の最適化
- 知財・無形資産の有効活用に向けた基盤構築と強化

財務戦略｜資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応



現 状 認 識

- ROEは13～20%台を推移し、資本コストを上回る水準を維持
- PBRは2～4倍程度を推移するが、FY2021以降は低下傾向
- FY2021以降のPBRの低下は、資本効率向上に向けた財務目標値など各種開示情報の不足が要因と認識

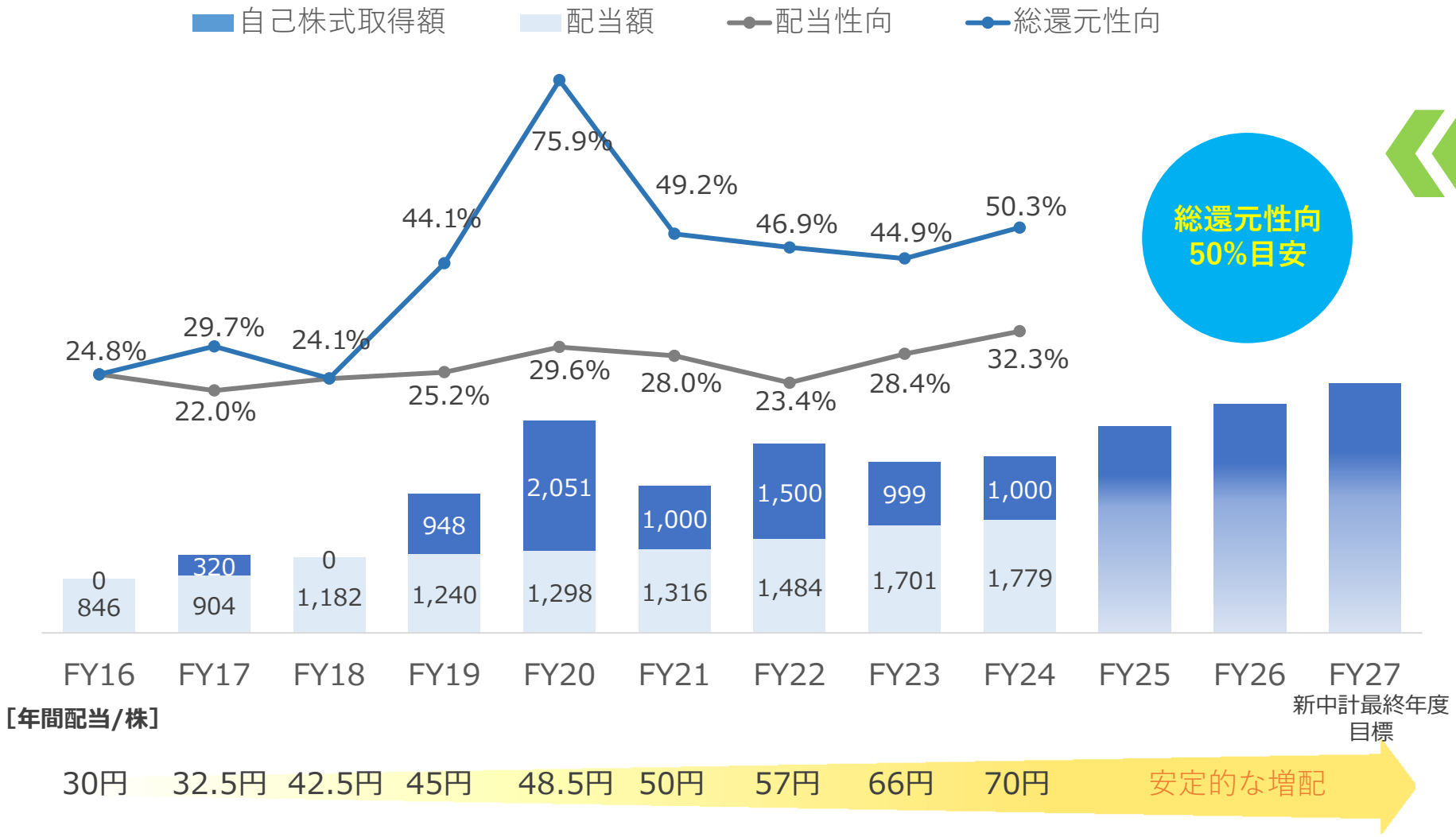
方　針

- 中期経営計画における財務目標値の達成を目指す
- 資本政策に基づき、成長投資と株主還元を推進
- 経営の透明性を高め、必要とされる情報を積極的に開示

具 体 策

- 成長分野への積極投資（営業キャッシュ・フローの50%程度）
- 資本効率向上に向けた財務目標値の設定
  （ROE：14%以上 <FY2027時点>）
- 株主価値向上策の実施（総還元性向：50%目安、安定的な増配等）
- ホームページ、統合報告書など情報発信の充実

財務戦略｜資本政策



総還元性向 50%目安

JCU VISION 2035 – 1st stage –
資本政策

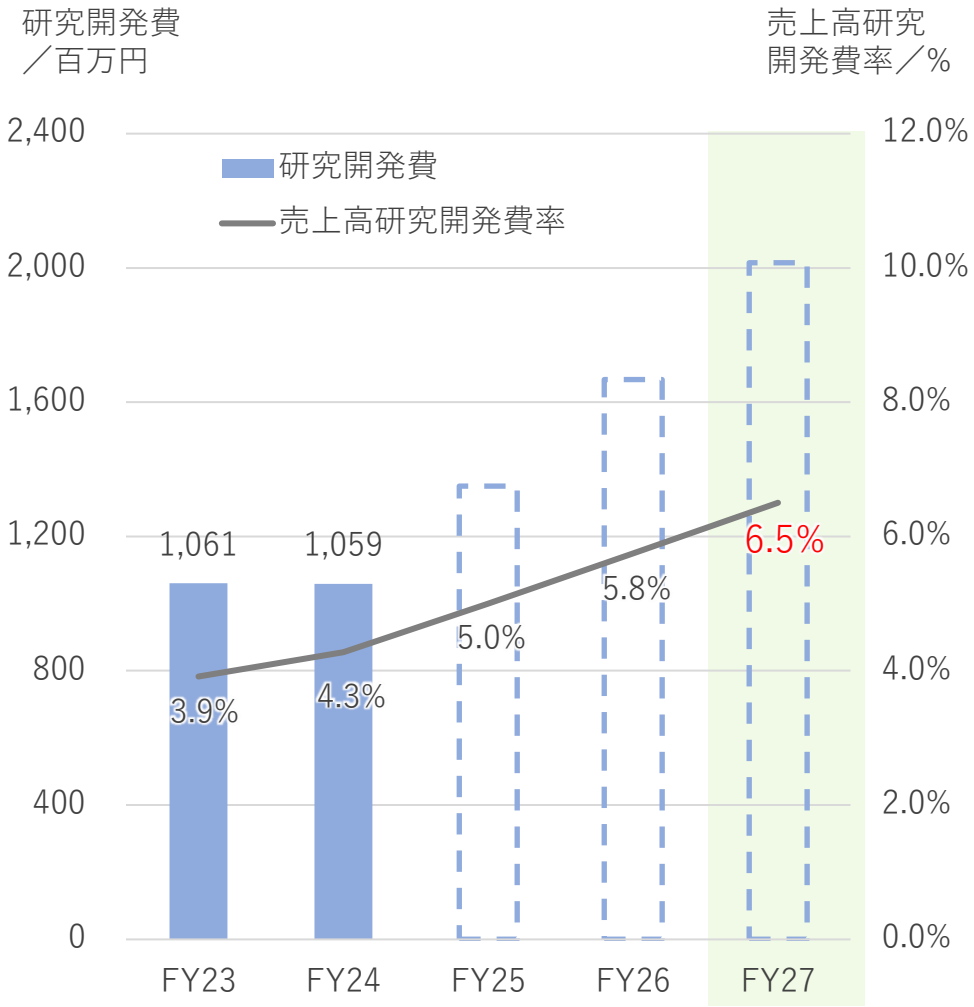
株主還元方針

- 総還元性向：50%目安
- 安定的な増配
- 機動的な自己株式取得の検討

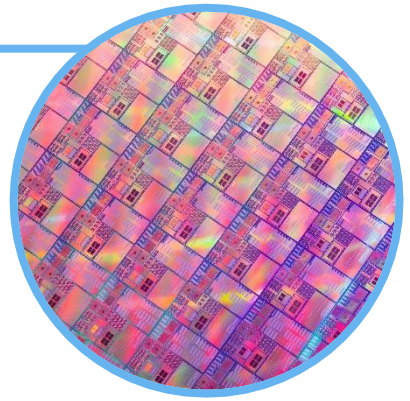
設備投資

- 成長分野への積極的な投資
- 自己資本を原資に設備投資やM&Aを検討

研究開発｜研究開発投資

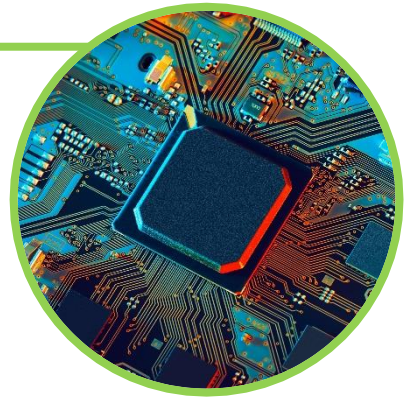


次世代領域



- 対象：半導体アドバンスドパッケージ（RDL, Cu Pillar, TSV, Hybrid Bonding etc.）
- 拠点：総合研究所・熊本事業所
- 製品：硫酸銅めっき薬品、エッチング薬品（TIPHARES シリーズ）

重点領域



- 対象：半導体パッケージ基板（FC-BGA, WB-CSP, FC-CSP etc.）
- 拠点：総合研究所
- 製品：硫酸銅めっき薬品（CU-BRITE シリーズ）
  エッチング薬品（SAC シリーズ）

サステナビリティ経営の推進｜当社のマテリアリティ

環境 Environment

- 環境を意識したイノベーションの創出
- 資源の保全と有効活用
- 気候変動対策への積極的な取り組み

社会 Social

- 労働安全衛生・保安防災
- 製品品質の向上
- 人的資本の有効活用
- 社会・環境に配慮したサプライチェーンの強化

ガバナンス Governance

- コンプライアンスおよびリスクマネジメントの強化
- 公正かつ透明性、実効性の高いガバナンス体制の実現と強化

技術 Technology

- 最先端技術を世の中に提供し、デジタル社会の進化に貢献
- DX（AI含む）を活用し、業務の効率化と事業の成長

TOPICS｜熊本事業所

熊本事業所のポイント

1 開発、生産およびサービス部門の連携強化による付加価値の向上

2 次世代領域の研究開発に特化した最新鋭の研究施設

3 生産性、効率性、安全性を備えた最新鋭のスマートファクトリー

4 環境負荷低減および地域環境保全を目指したクリーンな事業所

5 九州地区の産学連携強化の推進

熊本事業所

研究開発：R&D

最新鋭クリーンルーム

最新鋭研究設備

生産：Production

全自動生産設備

無人搬送車（AGV）

環境：Environment

太陽光パネルによる省エネ化

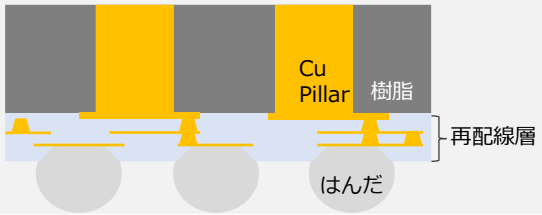
水リサイクルシステム

TOPICS｜TIPHARES シリーズ

RDL（再配線用）

◆ TIPHARES RDP

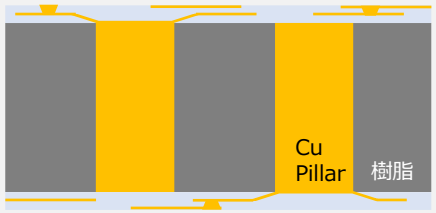
新製品としてFY2024より拡販中



ピラー（縦方向電極用）

◆ TIPHARES BUP

新製品としてFY2025より拡販予定



TSV（シリコン貫通電極用）

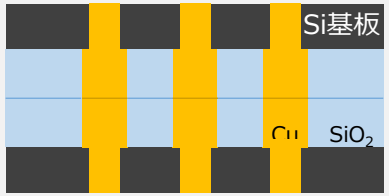
◆ TIPHARES TVP

新製品としてFY2025より拡販予定

ハイブリッド接合

◆ 開発品

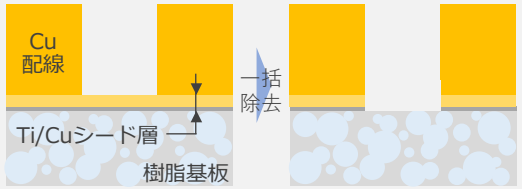
次世代接合技術として開発中



シード層一括除去

◆ TIPHARES TCE

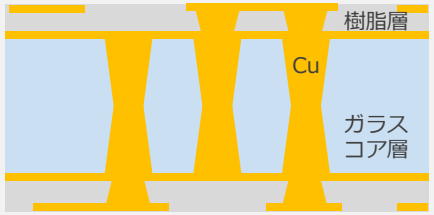
新製品としてFY2024より拡販中

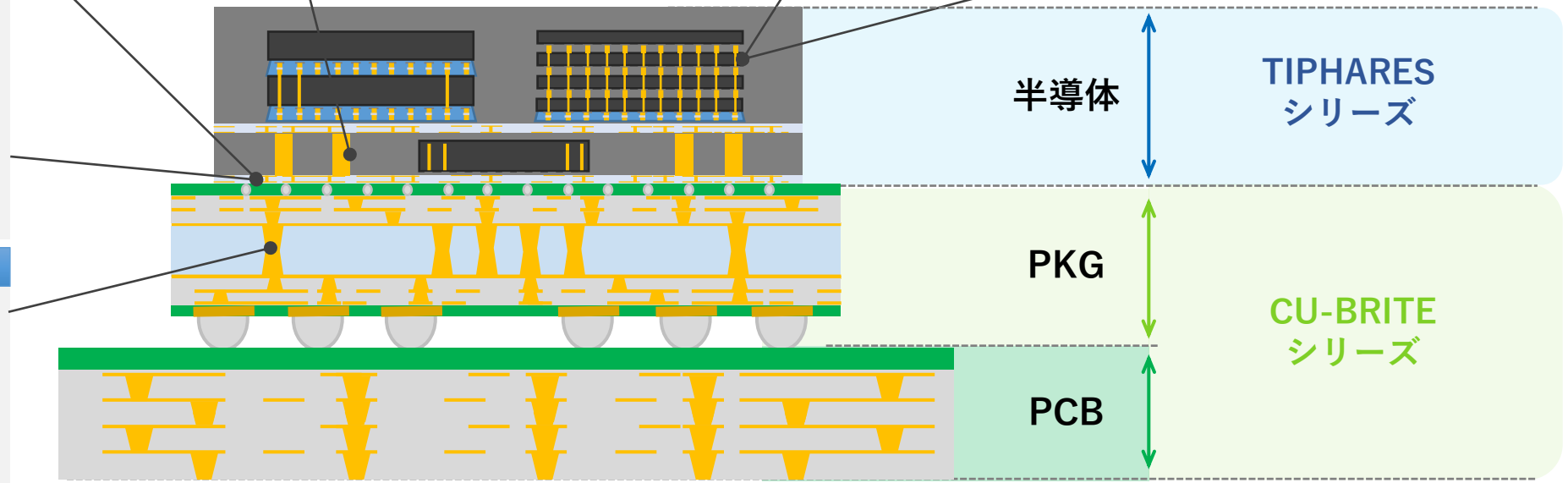


TGV（ガラス貫通電極用）※

◆ 開発品

次世代接合技術として開発中





※TIPHARESシリーズではInterposer向けを想定

会 社 概 要

創　　業	：	1957年 12月
設　　立	：	1968年 4月 1日
資 本 金	：	12億6,692万円
年　　商	：	単体 138億円　　連結 248億円　　（2024年3月期末）
本社所在地	：	東京都台東区東上野 4-8-1　TIXTOWER UENO 16階
業務内容	：	表面処理薬品、表面処理装置及び関連資材の製造・販売
代表者	：	代表取締役社長兼CEO　　木村 昌志
従業員数	：	単体 235名　　連結 538名　　（2024年3月期末）

ISO認証取得

ISO9001　生産本部・本社営業部・総合研究所　JCQA-0281

ISO14001　生産本部・総合研究所　JCQA-E-0143

今後必要とされる表面処理技術 －電子分野－

ターゲット　高機能電子デバイス、通信インフラ、カーエレクトロニクスなどの次世代IC-PKG基板

注力すべき表面処理技術

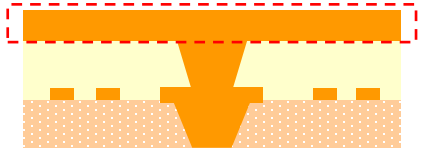
ビアフィリングめっき技術

①面内均一性向上

これまで：銅配線の高さが不均一

今後の技術：銅配線の高さが均一

②薄膜埋まり性向上

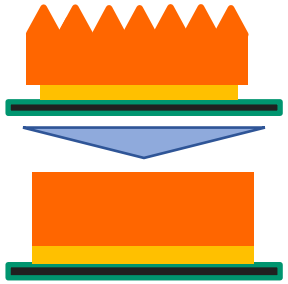


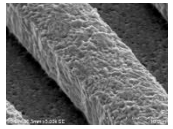
穴を埋める際、表層膜厚が厚くなる

穴を埋める際、表層膜厚を薄くする

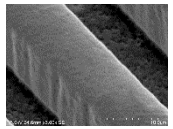
エッチング技術

③矩形性維持&平滑性向上



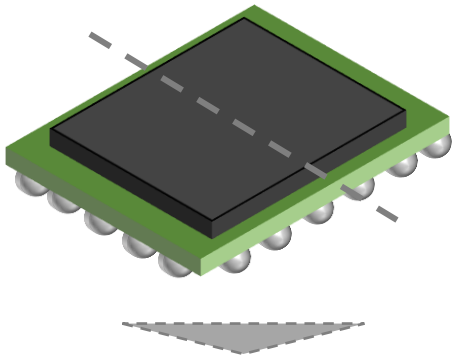


エッチング後の銅配線表面が粗れて凹凸ができる

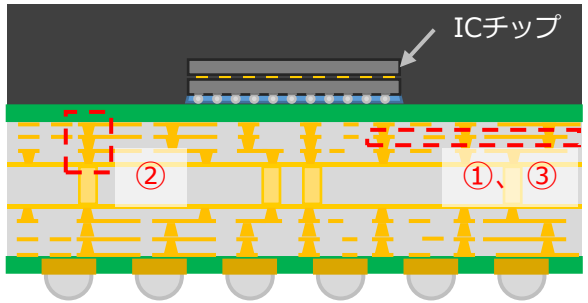


エッチング後の銅配線表面が滑らかな状態を維持できる

半導体パッケージ基板の模式図



半導体パッケージ基板の断面図



今後必要とされる表面処理技術 －装飾・機能分野－

ターゲット	自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等）、 水栓部品　（シャワーヘッド、排水栓等）

注力すべき表面処理技術：低環境負荷表面処理技術

①環境規制物質不使用の代替プロセス

これまで

人体に有害とされる
6価クロムイオン

使用される工程
- 前処理
  - エッチング
- 後処理
  - めっき
  - 電解化成処理

今後の技術

全工程で人体に有害とされる
6価クロムイオンを使用しない
環境配慮型プロセスの展開

各種めっき後の外観写真

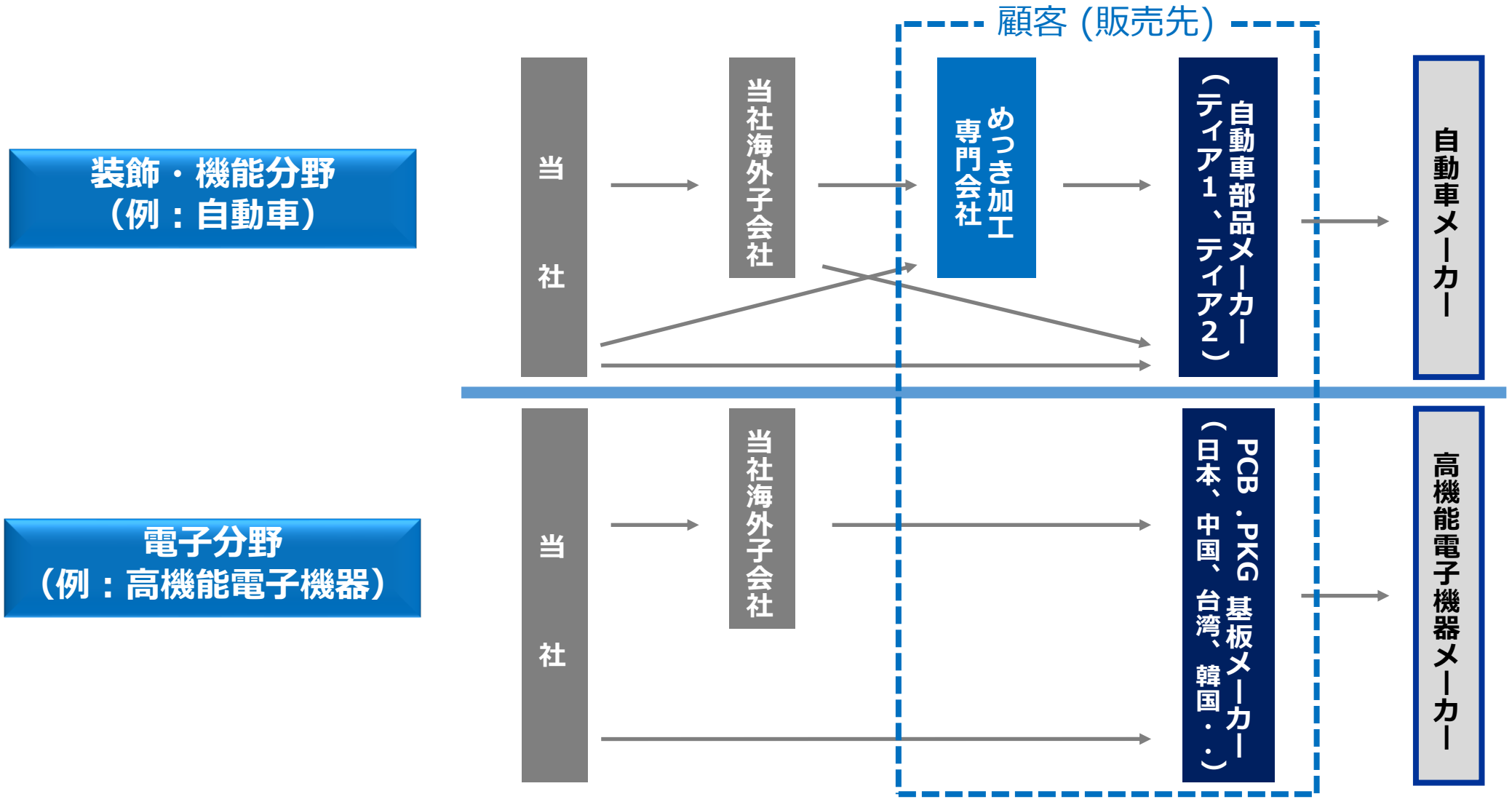
②低環境負荷装飾用銅めっきプロセス

染料系銅めっき用
添加剤

製造工程で環境負荷の
高い薬品を使用

環境に負荷がかかる薬品を使用せず、
従来と同等の性能を実現する
非染料系銅めっき用添加剤を開発

主な商流

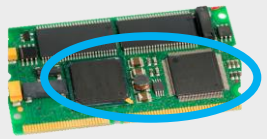

装飾・機能分野
（例：自動車）
電子分野
（例：高機能電子機器）
顧客（販売先）
当社
当社海外子会社
めっき加工専門会社
自動車部品メーカー（ティア1、ティア2）
自動車メーカー
当社
当社海外子会社
PCB・PKG基板メーカー（日本、中国、台湾、韓国・・）
高機能電子機器メーカー

主な製品

薬品事業	装飾・機能分野向け (基幹薬品)	自動車部品（フロントグリル、ドアハンドル、エンブレム等） 水栓金具　（給水機器、シャワーヘッド、排水栓等） 建築部品　（ボルト、ナット等）
	電子分野向け (電子薬品)	プリント基板（両面板、多層板、ビルドアップ基板、パッケージ基板等） 電子部品　（リードフレーム、チップ部品、コネクター等） 半導体　（シリコンウエハー）

装置事業	全自動表面処理装置	素材の投入からめっきの完成まで自動運転をする装置
	付帯機器	表面処理装置に付随する、ろ過機等の付帯機器の製造販売
	自動分析管理装置	めっき液の濃度を分析し不足分を補給して、自動で管理する装置
	プラズマ装置	プリント基板のめっき前処理用等の洗浄処理装置

薬品用途説明 最終製品例

用語説明		最終製品
機能・装飾薬品	装飾・防錆分野向け、金属外観の付与、サビ防止などの機能性付与のための表面処理(めっき)薬品。	自動車部品、水栓金具、建築部品
POP薬品 (Plating on Plastics)	基幹薬品の主力製品 プラスチック上へ金属膜をめっきするための薬品 	(自動車部品) フロントグリル、エンブレム など (水栓金具) シャワーヘッド、水栓コック など
その他基幹薬品	銅・鉄鋼などの金属素材へ金属膜をめっきするための薬品	(建築部品) ネジ、蝶番 など
電子薬品	電子信号を流すための回路、電子部品の電気接点などプリント配線板を製造するためのめっき薬品	5G関連部品、データセンター等のインフラ、高機能電子デバイス
ビアフィル薬品 (プリント基板/マザーボード向け)	電子製品に内蔵される プリント基板/マザーボードに 配線を形成するための銅めっき薬品	(5G関連部品) 5G基地局、車載基板、スマート家電 など (データセンター等のインフラ) 通信サーバー向けマザーボード など (高機能電子デバイス) スマートフォン、PC、タブレット、ゲーム機器 など
ビアフィル薬品 (半導体パッケージ(PKG)基板向け)	半導体チップを外部環境から保護し、 プリント基板に実装するための 基板(半導体PKG基板)に、配線を 形成するための銅めっき薬品 	
その他電子薬品	マザーボード、または半導体PKG基板に配線を形成する際、不要な銅を削るためのエッチング薬品 コネクタ、リードフレーム用のめっき薬品など	

この資料には、当社の現在の計画や業績見通しなどが含まれております。それら将来の計画や予想数値などは、現在入手可能な情報をもとに、当社が計画・予測したものであります。実際の業績などは、今後の様々な条件・要素によりこの計画などとは異なる場合があり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません。

当社ホームページ:
https://www.jcu-i.com/

お問い合わせ先：経営戦略室
Email： ir2@jcu-i.com
TEL： 03-6895-7004